

# 微电机用塑封料 常州 BMC团料

产品名称	微电机用塑封料 常州 BMC团料
公司名称	常州市晨光玻璃钢复合材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	产商/产地:常州 材质:BMC团料 制品分类:电机用塑封料
公司地址	武进区礼嘉镇陆庄村
联系电话	13701485258

## 产品详情

产商/产地	常州	材质	BMC团料
制品分类	电机用塑封料	颜色	全色
产品规格	1 ( mm )		

我公司具有成熟的bmc注射成型工艺及专用微电机壳bmc材料。目前也是我公司特色产品之一

塑封料，又称环氧塑封料（emc，epoxy molding compound）以其高可靠性、低成本、生产工艺简单、适合大规模生产等特点，占据了整个微电子封装材料97%以上的市场。现在，它已经广泛地应用于半导体器件、集成电路、消费电子、汽车、军事、航空等各个封装领域。环氧塑封料作为主要的电子封装材料之一，在电子封装中起着非常重要的作用。随着芯片的设计业、制造业和封装业的发展，环氧塑封料也得到了快速的发展。先进封装技术的快速发展为环氧塑封料的发展提供巨大的发展空间的同时也给环氧塑封料的发展提出了很大的挑战。目前，满足超薄、微型化、高性能化、多功能化，低成本化、以及环保封装的要求，是当前环氧塑封料工艺所面临的首要解决问题。

常州市晨光玻璃钢复合材料有限公司座落于常州市武进高新工业园区南区龙域西路.是一家有着雄厚的技术开发力量、丰富的市场营销经验、良好的科学管理体系，集科研、开发、生产、经营、技术服务为一体的专业化经济实体。公司汇集了从国外引进的全球领先的smc/bmc生产技术和经验丰富的高级技术精英，专业生产各种类型的smc/bmc、模压产品和玻璃钢制品，为广大客户提供专业的产品和服务。公司致力于生产各种类型的低收缩、低波纹型和a级表面smc/bmc产品，能够压制具有阻燃、绝缘、防腐、高强度、高韧性等各种性能模压制品，广泛应用于公路和汽车、电工电器、化工、建筑、铁路及其交通工具等许多领域，模压产品具有机械性能高、尺寸精确、电气性能好等特点，并且可以根据客户的各种具体产品的性能要求设计smc/bmc配方，以满足客户不同产品的特殊要求，同时还可以针对不同压制产品的工艺要求为客户提供增值的全面专业的技术支持和服务。我们恪守“以人为本、以诚为信、以质取胜”的经营理念，坚持发扬“团结、务实、开拓、创新”的企业精神，致力于为广大客户和各界朋友竭诚服务。极目未来，走向世界，热忱欢迎与国内外客商和各界朋友精诚合作，共创复合材料行业的美好未来。

环保塑封料的市场作用。现在，全球环保意识的提高，更加注重电子零组件的无铅（lead free）封装，也称为绿色封装（green package）技术研发。欧盟提议至2008年全面禁止使用电子含铅焊料，日本大厂也多在2004年至2005年，以无铅技术生产产品，两者意图通过限制性法令形成非关税障碍（non-tariffs barrier），达到保护市场的目的。信息电子、半导体企业未来只有符合环保标准、法令，才能在全球高单价市场上，抢转头角，突破全球市场非关税障碍，提高国际竞争力。所以，全球的各大塑封料厂家都在开发环保塑封料上投入了大量的精力，如何研究和开发绿色环保塑封料已经成为全球塑封料产业的焦点问题。目前，绿色封装对塑封料的要求主要有两个方面：一是不含有传统溴/锑的卤化物阻燃剂，而且要达到ul94 v - 0级标准；二是要满足无铅焊料工艺的260 °C高温回流焊考核要求。经过研究人员的探索，寻找不含有传统溴/锑的卤化物阻燃剂的替代品已经不成问题，而且可以满足ul v - 0的阻燃标准。但是，按照msl - jedec的可靠性考核标准，必须要通过260 °C的高温回流焊，在这种考核中往往会出现高温可靠性问题，所以很难通过msl1：85 °C /85%/168h + ir reflow 260 °C 3times这种一级考核，甚至msl2：85 °C /60%/168h + ir reflow 260 °C 3times考核。应该说这是环保塑封料研究的难点问题，也会影响环保塑封料的市场推广和应用。另外，还有成本问题也将会影响和推迟环保塑封料的市场推广和应用，一般来说，环保塑封料的成本是同类普通产品成本的两倍以上，甚至十几倍，一般客户也很难接受这种高成本材料。因此，如何解决高温可靠性技术问题和降低成本是当前发展和推广环保塑封料的主要研究课题。

### 3国外国内塑封料厂家情况

目前，国外环氧塑封料生产厂家主要集中在日本、美国、韩国、新加坡等国，主要有住友电木、日东电工、日立化成、松下电工、信越化学、东芝、hysol、plaskon、samsung等，此外中国台湾地区也有一些规模可与国外企业相比较的大厂，例如台湾长春等厂家。现在，环氧塑封料的主流产品是适用于0.35 μm - 0.18 μm特征尺寸集成电路的封装材料，研究水平已经达到0.1 μm - 0.09 μm，主要用于sop、qfp、bga、csp、mcm、sip等

目前，国内环氧塑封料厂家总共有8家，分别是江苏中电华威（现为汉高华威电子有限公司）、北京科化所、成都齐创、浙江新前电子、佛山亿通电子、浙江恒耀电子、住友（苏州）电子、长兴（昆山）电子，台湾长春和日立化成也已经分别在常熟和苏州建厂。现在，国内大规模生产技术能够满足0.35 μm - 0.25 μm技术用，开发水平达到0.13 μm - 0.10 μm，主要应用于sip、dip、sop、pqfp、pbga等形式的封装。

另外，国内还有部分外资环氧塑封料生产厂家，由于他们依靠国外比较成熟的技术和先进的研发手段，以及强大的实力作为后盾，所以他们的产品主要处在中高档水平，主要应用于qfp、bga、csp等比较先进的封装形式以及环保封装领域，基本上占据了国内大部分的中高端市场。